

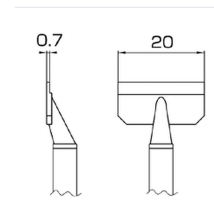
Composite-Entlötspitze SOP 20L - Hakko T16-1010

Artikel-Nr.	HK-T16-1010	Hersteller	Hakko
Hersteller-Nr.	T16-1010	EAN	4962615028144

Composite-Entlötspitze im Format SOP 20L für die Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette. Die Packung enthält 2 Ersatzspitzen zur effizienten Demontage von SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Überblick

Die Hakko T16-1010 ist eine Composite-Entlötspitze, die speziell für das Parallel-Entlötpinzettensystem FM 2022 entwickelt wurde. Im Format SOP 20L ausgeführt, ermöglichen diese Spitzen das präzise und effiziente Entfernen oberflächenmontierter Bauteile von Leiterplatten, ohne benachbarte Komponenten oder Leiterbahnen zu beschädigen.

Wesentliche Merkmale

- Format SOP 20L für standardisierte Kompatibilität mit SMD-Gehäusen
- Composite-Aufbau für optimale Wärmeübertragung und Langlebigkeit
- Packung mit 2 Ersatzspitzen für eine verlängerte Einsatzdauer

- Ausschließlich für die Parallel-Entlötpinzette FM 2022 konzipiert
- Ermöglicht kontrolliertes, gleichzeitiges Entlöten mehrerer Anschlüsse
- Reduziert die thermische Belastung von Leiterplatte und angrenzenden Bauteilen

Technische Daten

Spitzenformat	SOP 20L
Kompatibilität	Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette
Material	Composite
Menge pro Packung	2 Spitzen
Herkunftsland	Japan

Anwendungen

Ideal für die Elektronikfertigung, das Rework von Leiterplatten und den Austausch von Bauteilen. Besonders geeignet zum Entlöten von Small-Outline-Gehäusen und anderen oberflächenmontierten Bauteilen in Präzisionsmontageumgebungen.

Lieferumfang

- 2 × Composite-Entlötspitzen (Format SOP 20L)